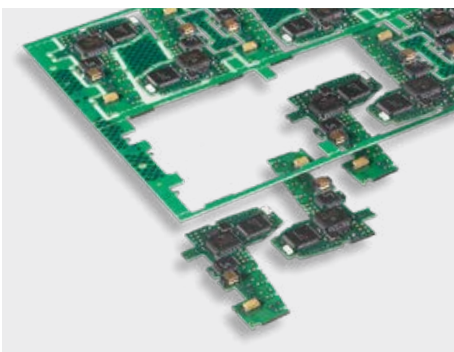


PCBとFPCの分割をUVレーザーで実現  
コンベアを接続し連続生産へ  
LPKF MicroLine 2000 Ci



## 自動搬送に対応

コンベアを接続することで連続生産が可能になります。コンベアとの接続はSMEMAインターフェースにて行われます。

## 工程時間短縮へのソリューション

高価な金型や刃物などを交換する代わりに加工データを選択するだけでLPKF MicroLine 2000 Ciは様々な材料を加工できます。MicroLine 2000 Ciは非常にコンパクトかつユーザーフレンドリーな簡単操作で多品種生産と高品質化を両立しながら低価格なレーザーシステムです。

### 技術データ: LPKF MicroLine 2000 Ci

レーザー安全クラス	1
最大ワークエリア (X x Y x Z)	300 mm x 250 mm x 11 mm
カメラ認識エリア (X x Y)	300 mm x 250 mm
最大ワークサイズ	300 mm x 250 mm
入力データフォーマット	Gerber, X-Gerber, DXF, HPGL, Sieb & Meier, Excellon, ODB ++
最大加工スピード	加工対象により異なる
位置決め精度	± 25 µm
レーザースポット径	20 µm
レーザー波長	355 nm
装置寸法 (W x H x D)	875 mm x 1530 mm x 1300 mm*
装置重量	~ 450 kg
動作環境	
電源	230 VAC, 50 – 60 Hz, 3 kVA
冷却	空冷(内蔵冷却サイクル)
圧縮エア	0.6 MPa
環境温度	22 °C ± 2 °C @ ± 25 µm / 22 °C ± 6 °C @ ± 50 µm
湿度	< 60 % (結露なきこと)
必須アクセサリ	専用集塵機、外部コンベア、ワーク固定ツール

\* ステータスライト込の高さ = 2020 mm

MicroLine 2000 Ci シリーズは MicroLine 2120 Ci (10 Wレーザーソース) と MicroLine 2820 Ci (15 Wレーザーソース) で構成されています。

#### ワールドワイド(LPKF 本社)

LPKF Laser & Electronics AG Osteriede 7 30827 Garbsen Germany  
Phone +49 (5131) 7095-0 info@lpkf.com www.lpkf.com

#### 北米/南米

LPKF Laser & Electronics North America  
Phone +1 (503) 454-4200 sales@lpkfusa.com www.lpkfusa.com

#### 中国

LPKF Tianjin Co., Ltd.  
Phone +86 (22) 2378-5318 sales.china@lpkf.com www.lpkf.com

#### 日本

LPKF Laser & Electronics 株式会社  
〒273-0012 千葉県船橋市浜町2丁目1-1 ららぽーと三井ビルディング8F  
Phone +81 (0) 47 432 5100 info.japan@lpkf.com http://jp.lpkf.com

#### 韓国

LPKF Laser & Electronics Korea Ltd.  
Phone +82 (31) 689 3660 info.korea@lpkf.com www.lpkf.com

LPKF Laser & Electronics AGは製品の販売、マーケティングを行い、世界 50 ヶ国以上でサポートを提供しています。お近くのパートナーを [www.lpkf.com](http://www.lpkf.com) でお探してください。